

NEWS RELEASE

光半導体事業の生産能力増強のため
新貝工場に新棟を建設
地鎮祭は3月1日

2023年2月24日
浜松ホトニクス株式会社
本社：浜松市中区砂山町 325-6
代表取締役社長：丸野 正(まるの ただし)

当社は、半導体製造・検査装置やLiDAR（※）向け光半導体素子の後工程（切り出し・組立・検査工程）の生産能力を増強し売上拡大に対応するため、新貝工場（浜松市南区新貝町）に新棟を建設します。

新棟建設の地鎮祭は3月1日（水）に執り行い、2025年3月に竣工の予定です。

※ LiDAR：Light Detection and Ranging の略。対象物にレーザ光を照射し、その反射光を光センサでとらえて距離を測定するリモートセンシング技術で、自動運転の分野で注目されている。



当社は、医療や産業、自動車などのさまざまな分野に光半導体製品を供給しています。近年、半導体製造・検査装置向けイメージセンサの需要拡大が続いており、今後も売り上げ増加が見込まれています。また、自動車用のLiDAR向けフォトダイオードの市場拡大も期待されることから、今回、新貝工場に新棟を建設し後工程の生産能力を増強します。

新棟建設により、イメージセンサやフォトダイオードの生産スペースを拡張し、需要の拡大に対応します。また、新棟と2つの既存棟を接続し新貝工場のクリーンルームを一体化することで、人や物の移動を効率化し生産性を高めるとともに、デジタルトランスフォーメーションによる製造工程の自動化と省人化を図ります。

新棟は、事業継続計画に基づく地震対策や水害対策を建物構造に取り入れることで災害対策を強化するとともに、断熱構造や太陽光発電設備などの環境対策を積極的に取り入れた設計としています。なお、今回の新棟建設により、新貝工場での大型設備投資は完了します。

今後、光半導体のさらなる需要拡大が見込まれており、前工程（プロセス工程）では本社工場に新棟を建設し、従来の直径6インチよりも面積の大きい直径8インチのシリコンウエハに対応した製造工程を、2025年9月期までの3年間で確立します。後工程では、今回の投資を含めキャパシティの拡充を進め生産体制を強化することで、10年後には光半導体事業の売上倍増を目指します。

新棟の地鎮祭および概要につきましては以下の通りです。

<地鎮祭>

式典名称 浜松ホトニクス株式会社 新貝工場3棟 地鎮祭
日 時 2023年3月1日（水） 午前10時00分～
場 所 静岡県浜松市南区新貝町1128番地

<新棟概要>

建物名称 新貝工場3棟
建築場所 静岡県浜松市南区新貝町1128番地
建築工期 2023年3月着工、2025年3月竣工予定
稼働予定 2025年5月
建築構造 鉄骨造 地上4階
建物面積 建築面積 3,823㎡、延床面積 13,343㎡
施設構成 1階 光半導体素子の組立工程（クリーンルーム）
2階 光半導体素子の組立工程（クリーンルーム）
3階 光半導体素子の組立工程（クリーンルーム）
4階 工程設計事務所、検査工程
R階 太陽光発電施設（自家消費）
総工費 約75億円
収容人員 約100名
生産品目 イメージセンサ、フォトダイオード
生産能力 約300億円（売上高換算）

以上



新貝工場3棟 完成予想図

<この件に関するお問い合わせ先>

■報道関係の方 浜松ホトニクス株式会社 広報室 野澤利行
〒430-8587 浜松市中区砂山町 325-6 日本生命浜松駅前ビル
TEL053-452-2141 FAX053-456-7888 E-mail: tnozawa@hq.hpkk.co.jp
時間外は、携帯電話 090-7695-1616 へお願いします